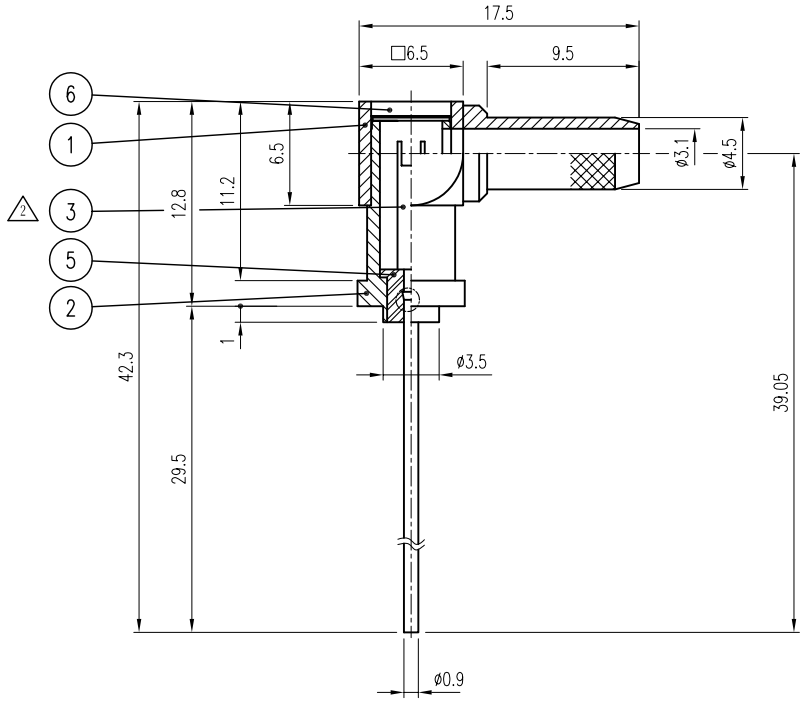
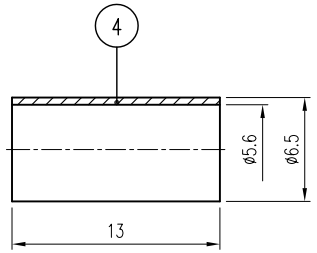
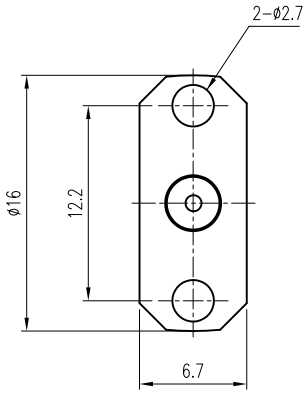
ST \ 기종										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	(설변No.연구2005-238) 기타 (도금두께 변경)	김인철	최종락	2005. 10. 7.
2	신립장 용접 (설변No.연구2006-149) (PN 발렌 방지 낙사비는 삽입)	김인철	윤상진	2006. 7. 27.







	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	6	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00030-5/1 (L3012)
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00081-N/1 (H2299)
1	4	FERRULE	1	MBsBD	SUCO Plate ~~SUCO Plate(6μm)~~	DFE00060-5/1 (F2030)
2	3	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate(6μm)	DCT00109-5/1 (E2451)
1	2	BODY(B)	1	MBsBD	SUCO Plate ~~SUCO Plate(6μm)~~	DBD01245-1/1 (D2400)
1	1	BODY(A)	1	MBsBD	SUCO Plate ~~SUCO Plate(6μm)~~	DBD01246-3/1 (D2399)

대체가능재질			
공통공차	년월일	2005. 1. 25.	
소수 각도 분수	승인		
	검도		
재질	제도		
열처리	검도		
보호피막처리	작성부서	연 구 소	
	척도 1.5/1	단위 mm	중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-H2-C-RG223 VER.2

A3 도번 K314-826-001

K314-826-001